

1. \*Размеры для справок;

2. Плату изготовить комбинированным позитивным методом;

3. Материал заменитель: СФ-2-35Г-2 1кл. ГОСТ 10316-76;

4. Шаг координатной сетки 1.25 мм;

5. Конфигурацию проводников выдержать по чертежу с отклонением 0.05 мм с учетом обеспечения необходимых зазоров в узких местах;

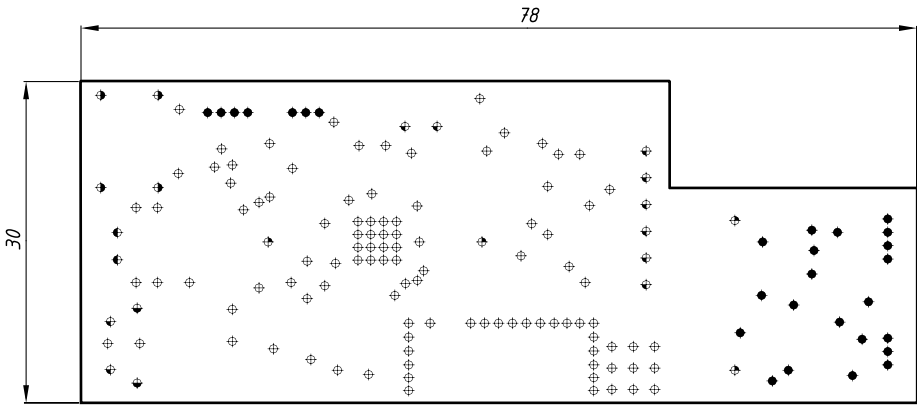
6. Финишное покрытие: 0-Ко.Гоп.ПОС-61;

7. Переходные отверстия паяльной маской не закрывать;

8. Машинным носителем информации является файл в формате системы проектирования Altium Designer - 2023;

9. Расстояние от контура платы до печатных проводников или контактных площадок не менее номинальной толщины платы;

10. Остальные требования по ОСТ 450.070.014.



Условное обозначение	Количество отверстий	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации
⊕	104	0.3	Plated
●	28	0.5	Plated
⦿	4	0.6	Plated
⦿	2	0.9	Plated
⦿	10	1.0	Plated
⦿	2	1.3	Plated
⦿	4	3.2	Non-Plated
	154 Total		